

证券简称：艾为电子

证券代码：688798

上海艾为电子技术股份有限公司

投资者关系活动汇总表

(2026年6月10日-2026年6月18日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	诺安基金、中庚基金、中邮证券
时间	2026年6月10日、2026年6月18日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：余美伊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：解读公司2026年第一季度报告并介绍公司概况、公司成长、公司团队、主要产品线等。</p> <p>第二部分：问答环节</p> <p>问题一：公司2026年第一季度各下游客户的需求情况？</p> <p>回答：一季度消费电子下游市场受存储供应短缺影响面临阶段性挑战，公司通过持续优化产品矩阵、加速新产品迭代导入，实现了国内市场份额的相对稳定；同时，公司持续深化海外客户拓展，相关业务在一季度实现较快增长。在工业领域，公司积极把握制造业需求复苏、自动化渗透率持续提升的行业机遇，在工业控制、能源、通信、医疗等市场持续拓展客户资源，多款新产品陆续实现量产并逐步形成规模化交付能力。在汽车电子领域，公司依托车规级呼吸灯、中大功率音频及电源管理等产品的技术积淀，与存量客户的合作持续深化，相关业务保持较快增长；同时，新客户拓展也取得进展，多家国内主流新能源车企已顺利进入规模化交付阶段。</p> <p>问题二：公司2026年第一季度毛利率下降的原因？</p>

回答：一季度综合毛利率的下降，主要是公司应对市场需求结构的变化，在保持市场份额的同时，对产品矩阵和定价体系进行了适当优化，上述经营策略在短期内对公司综合毛利率带来一些压力。

问题三：面对今年晶圆成本上涨带来的毛利率压力，公司如何应对？

回答：针对上游晶圆厂产能紧张导致成熟制程代工价格上涨带来的成本压力，公司主要通过两项举措积极应对，以缓解其对综合毛利率的不利影响：一是加快推进新产品在下游客户端的验证与导入进度；二是进一步优化业务结构，加快提升工业、汽车业务板块的收入占比，这两个业务板块的毛利率相对优于消费电子业务。

问题四：公司费用投入情况如何？

回答：公司一季度总费用投入为 2.01 亿元，同比增长 11.6%。其中，销售费用同比下降 8.3%，管理费用同比增长 3.3%。公司继续加大研发投入力度，研发费用投入 1.28 亿元，同比增长 4.1%，研发投入占营业收入的比例为 19.79%，较 2025 年同期提升 0.58 个百分点。此外，一季度财务费用增长较快。一方面是受美元汇率波动影响，产生汇兑损失 1,246 万元，另一方面，公司在一季度完成可转债发行后，计提利息费用 662 万元。

问题五：研发人员情况及研发进展？

回答：截至 2025 年底，公司研发人员 674 人，同比增长 22.1%，占公司总人数的 69.6%；掌握核心技术 75 项，累计取得发明专利 484 个，实用新型专利 238 个，外观设计专利 7 个，软件著作权 134 个，集成电路布图登记 634 个。

问题六：公司新产品布局情况？

回答：今年以来，公司围绕音频、电源与信号链、传感器、端口保护等领域密集推出多款产品，进一步完善产品布局，为各业务板块增长提供坚实支撑。音频领域实现多点突破，先后发布 NPU 语音芯片、DSP 音频功放、中大功率音频功放、高保真音频开关，多款产品搭载自研 SKTune 神仙算法，通过集成 DSP、IV Sense

等技术实现性能升级，覆盖智能语音、消费电子、车载音频等场景需求。电源与信号链领域，推出双通道零漂移运算放大器、高效率升压变换器，前者完善了工业信号链产品布局，后者为便携设备提供稳定可靠的供电解决方案。传感器领域，发布高压 40V Hyper-Hall™，为工业智能化升级提供解决方案，进一步巩固公司在磁传感器领域的技术优势。端口保护领域，先后推出集成 8KV ESD 能力的高带宽 USB 保护开关、OVP+OCP 一体化保护芯片及 Plus-TVS 产品，分别针对 USB 接口、AI 可穿戴设备及端口浪涌防护场景，有效解决终端设备的安全防护痛点。

问题七：公司在端侧 AI 领域的整体布局思路和技术路线是怎样的？

回答：公司在端侧 AI 领域遵循“配套芯片为基础、端侧 AI 芯片为延伸、芯片与算法全栈协同”的布局思路。技术路线上，公司以现有电源管理、信号链等端侧 AI 配套芯片为技术底座，依托在数模混合芯片领域的积累，向 MCU+NPU、DSP+NPU 等端侧 AI 芯片延伸，并深入开展神经网络算法研究，构建“芯片+算法”的全栈技术体系，以满足端侧 AI 场景对低功耗、低延迟的要求。应用方向覆盖智能穿戴（AI 眼镜等）、AI 手机、AI PC 等智能设备终端，并逐步向工业、汽车等领域扩展。

问题八：公司车规测试中心的建设进展，该测试中心投产后会给公司带来哪些影响？

回答：公司上海临港车规级测试中心项目目前按既定计划推进，投产后将提升公司车规级芯片测试验证能力。随着公司汽车电子业务持续拓展，车规芯片测试需求快速增长，下游客户对产品质量与功能的要求不断提高，现有上游封测企业提供的测试服务已无法充分满足公司需求。同时，上游封测产能整体偏紧，外协厂商优先保障量产产品的测试需求，导致公司在研产品的测试排期与资源保障不足。公司车规级测试中心建成投产后，将有效缓解上述测试资源瓶颈，提升车规级芯片研发效率。根据建设规划，该测试中心可独立开展可靠性测试、产品性能测试分析及失效分析等业务，能够实现十万级的工程测试需求，对样品进行全面的性能验证；同时，可实现百万级的量产测试需求，对在产品的各类缺陷进行检测，保障产品良率。

证券简称：艾为电子

证券代码：688798

	<p>问题九：请问公司可转债募投项目的进展情况如何？</p> <p>回答：公司严格按照募集资金使用计划，推进各项募投项目建设。其中，全球研发中心及产业化一期项目已于 2025 年第四季度完成奠基，目前正稳步推进土建施工，各项建设工作按既定节点有序开展；与此同时，端侧 AI、运动控制、车载芯片等募投项目也在按计划稳步推进。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 6 月 19 日